



HoLR1206 封体合金系列规格书

| | |
|------|------------|
| 系列号 | HoLR |
| 修订日期 | 2019-04-19 |
| 版本号 | Ho-A0 |

规格书 Specification



制造商:深圳市毫欧电子有限公司

HoLR1206

适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR1206-75ppm 系列产品选型。

产品特点 Features:

- 合金芯片，封体工艺，焊接性能良好
- 高可靠性，高过载能力，产品精度高。
- 使用温度范围较宽无感型设计
- 电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 75ppm$
- 符合 ROHS 要求和无卤要求

产品名称 Product Name

封体合金电阻

产品型号 Product number

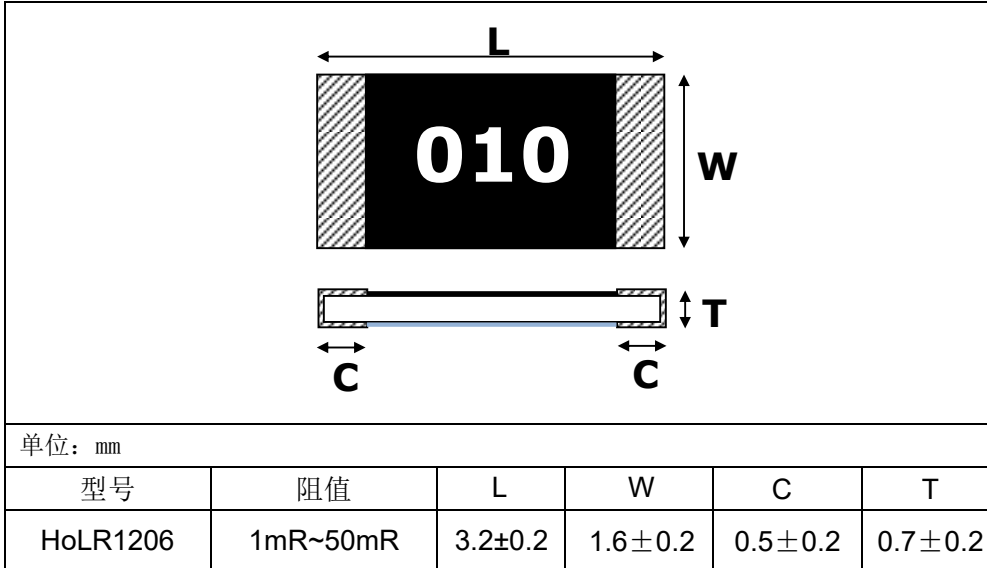
| Ho | LR | 1206 | 1W | 5mR | 1% | 75ppm |
|---------|-------|------|---------|--------|----------|-------------------|
| 制造商 | 产品系列 | 封装 | 额定功率(W) | 阻值(mR) | 精度(%) | 温度系数 TCR (ppm) |
| Ho 毫欧电子 | LR 合金 | 1206 | 1 | 1~50 | ±1 ±5 | ≤75 |



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

| | |
|------|------------|
| 系列号 | HoLR |
| 修订日期 | 2019-04-19 |
| 版本号 | Ho-A0 |

■ 产品尺寸 Product Size

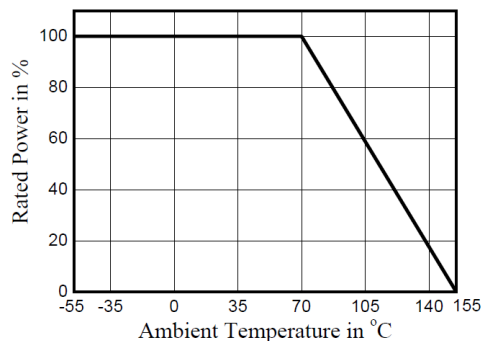


■ 电气参数 Electrical parameter

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 额定功率 Rated power | 1W |
| 阻值范围 Resistance range | 1mR~50mR |
| 最大额定电流 Max.Rated Current | 31.62A |
| 准确度等级 AccuracyClass | 1%、2%、5% |
| 电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C) | ≤75 |
| 工作温度范围 Operating Temperature Range | -55°C~+155°C |

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 - 55 ~ +155 °C 电阻温度达到 100 °C 时降功率示意图



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

| | |
|------|------------|
| 系列号 | HoLR |
| 修订日期 | 2019-04-19 |
| 版本号 | Ho-A0 |

■ 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu

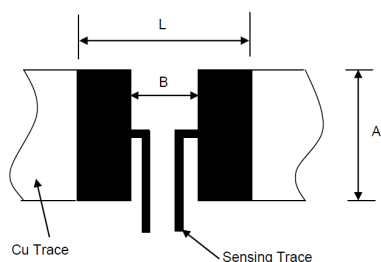
I :Rated Current (A)

P:Rated Power (W)

R:Resistance Value (Ω)

$$I = \sqrt{P/R}$$

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension

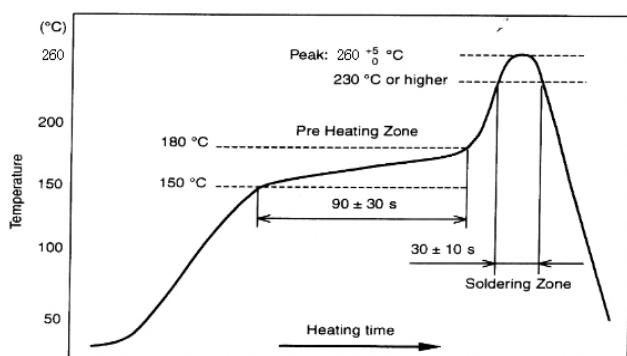


单位: mm

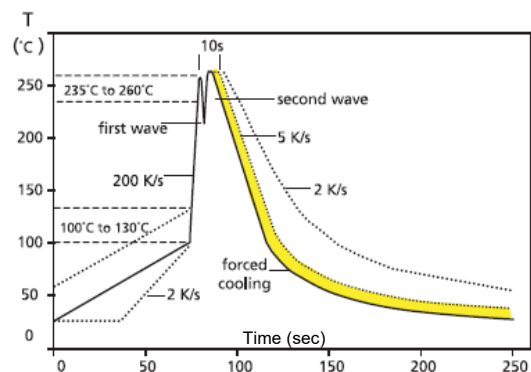
| 阻值 | A | L | B |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1mR~10mR | 1.8 | 4.7 | 1.2 |
| 11mR~20mR | | | 1.8 |
| 21mR~50mR | | | 2.2 |

■ 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters

预热: 150 to 180 °C, 90 ± 30秒, 焊接区: 230 °C 或更高, 30 ± 10 秒
峰值: 260 ± 5 °C, 5秒.

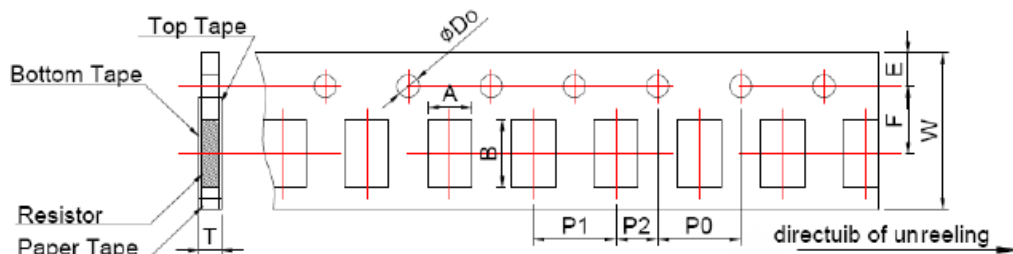


回流焊曲线图



波峰焊曲线图

地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)


| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|----------|----------|---------|--------|--------|------------|-----------|
| A | B | W | F | E | P1 | P2 | P0 | D0 | T |
| 2.0±0.2 | 3.6±0.2 | 8±0.2 | 3.5±0.05 | 1.75±0.1 | 4.0±0.1 | 2±0.05 | 4±0.05 | Φ 1.55±0.1 | 1.05±0.15 |

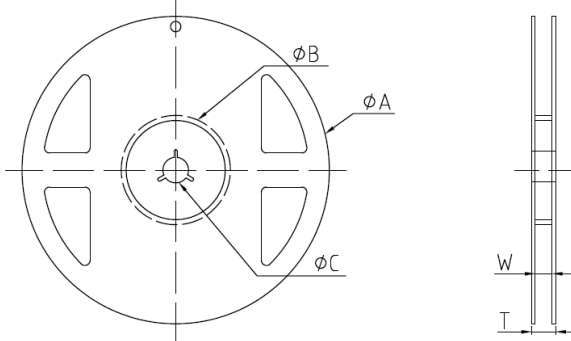
■ 可靠性测试 Reliability Tests

| Test Items | Reference standard | Condition of Test | Test Limits |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Temperature Coefficient of Resistance | IEC60115-1-4.8 JIS-C5201-4.8 | +25°C ~ +125°C | Refer 4.0 |
| Load Life | IEC60115-1-4.25.1 JIS-C5201-4.25.1 | 1000hours at rated power, 70°C, 1.5hours "ON", 0.5hour "OFF" | < ±1% |
| Short Time Overload | IEC60115-1-4.13 JIS-C5201-4.13 | 5 X rated power for 5s | < ±1% |
| Moisture no Load | IEC60115-1- 4.24.2.1a) JIS-C5201- 4.24.2.1a) | 85°C, 85%RH, 1000hrs | < ±1% |
| Temperature cycle | IEC60115-1-4.19 JIS-C5201-4.19 | -55°C & +155°C, 100cycle, 15min per extreme condition | < ±1% |
| Resistance to Soldering Heat | IEC60115-1-4.18 JIS-C5201-4.18 | 260±5°C for 10±1 sec | < ±0.5% |
| Solderability | IEC60115-1-4.17 JIS-C5201-4.17 | 245±5°C, 2±0.5sec | At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder |
| High Temperature Exposure | IEC60115-1- 4.23.2 JIS-C5201-4.23.2 | 155°C, 1000hrs | < ±1% |
| Low Temperature Storage | IEC60115-1- 4.23.4 JIS-C5201-4.23.4 | -55°C, 1000hrs | <±1% |
| Substrate Bending | IEC60115-1-4.33 JIS-C5201-4.33 | Bending width 2mm | < ±0.5% |
| Insulation Resistance | IEC60115-1-4.6 JIS-C5201-4.6 | 100V DC for 1 minute | >100 MΩ |

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

| | |
|------|------------|
| 系列号 | HoLR |
| 修订日期 | 2019-04-19 |
| 版本号 | Ho-A0 |

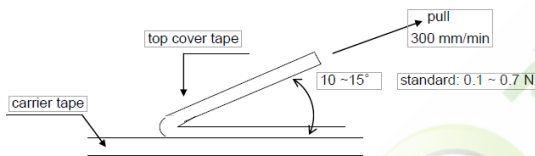
■ 卷轴规格 Reel Specification



| Φ A | Φ B | Φ C | W | T |
|----------|------|------|-----|--------|
| 180+0/-3 | 60±1 | 13±1 | 9±1 | 11.4±1 |

■ 顶盖胶带的剥离强度 Peeling Strength of Top Cover

试验条件：剥离速度为 300mm / min 时为 0.1~0.7N



储藏条件：温度：5℃~35℃，湿度：40%~75%

■ 包装方式 Packing

编带盘装：5000PCS/盘

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼